

最先进的自动化编程设备

- 速度:** 专为高产能需求而量身打造
- 多功能:** 专为高灵活度与零换线时间而设计
- 附加值:** 以前所未有的低总成本来拥有具备最佳性能的自动化设备



当速度成为关键因素

- 产出可达每小时2000片 (支持tray, tape及tube等包装, 支持大文件烧录)
- 快速文档下载
- 支持优化算法的FlashCORE III 编程器
- 支持Lumen™X编程器
- 视觉对准系统
- 零机械换线时间

当灵活性成为关键因素

- 极小芯片处理
1.5毫米 x 1.5毫米
- 可扩展性:
 - 可扩展至24个FlashCORE 编程器,96个烧录座
 - 可扩展至14个LumenX 编程器,112个烧录座
- 支持同时安装多种输入/输出系统
- 双Tray盘进料器
- 人性化设计的操作区域

当附加值成为关键因素

- 低总成本
- 持续支持新的芯片技术
- LumenX单体插座适配器
- 全球服务及技术支持

芯片处理系统

- 产能: 产出最高可达每小时2000片 (支持tray, tape及tube等)
- 放置精度: $\pm .03$ 毫米
- 放置力: 精确定位, 减小芯片引脚弯曲发生的可能性
- 取放方式: 2支独立真空吸头
- 检测: 真空传感器
- 框架尺寸: 1250毫米 宽 x 1280毫米 长 x 1500毫米 高 (不包括输入/输出选配件及显示器)
- 装箱规格: 1900毫米 宽 x 1600毫米 长 x 1600毫米 高 (不包括输入/输出选配件)
- 净重: 500Kg
- 装箱重量: 765Kg
- 安全标准: CE, RoHS, WEEE
- 定位方式: 运动中对准
- 支持封装尺寸: 最小/最大 (1.5毫米 x 1.5毫米) 至(32毫米 x 32毫米)

定位系统

- X-Y 轴驱动系统: 伺服皮带驱动
- X-Y 轴精度: $\pm .001$ 毫米使用线性编码器
- Theta轴精度: $.072^\circ$ 伺服驱动
- X-Y 轴编码器: 线性/旋转双编码器
- Z轴驱动系统: 步进皮带驱动
- Theta轴驱动系统: 伺服马达

输入/输出选配系统

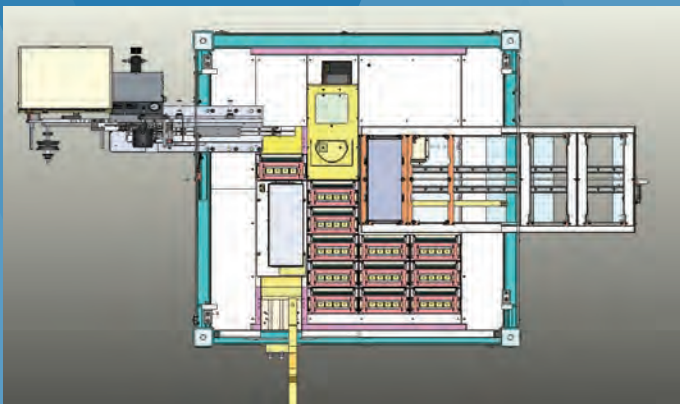
- 双Tray盘进料器: 独立的tray-in/tray-out系统, 可预防已编程芯片与未进行编程芯片被混装的问题发生
- Tape-In: 支持8毫米 至56毫米的 tape宽度
- Tape-Out: 支持8毫米 至56毫米的 tape宽度
- Tube-In / Out: 可直接安装
- 手动Tray: 可直接安装

选配打标机

- 激光标记: 脉冲固态光纤激光器, 可在28x28cm的区域打字母、数字及图片
- 功率: 10 W

其他选配系统

- 视觉系统: 3D 同平面检测系统



系统要求

- 气压: 80 psi (5.5 bar)
- 气流: 6 SCFM (最大)
- 环境温度: $13^\circ\text{C} - 32^\circ\text{C}$
- 输入电压: 单相220 VAC
- 输入频率: 50 - 60 Hz
- 功耗: 1.5 KVA (最大)
- 湿度: 35% 至90% RH 无凝结

软件

- TaskLink
- AH700
- ConneX
- Automotive Performance PAK
- Serial Number Server...

服务支持选项

- 操作培训
- 年度服务支持协议 (APS)

备件

- PSV7000 基本配件包
- PSV7000 补充备件包
- PS-FlashCORE III 备件包

编程内核

- FlashCORE III
- Lumen™X

全器件支持

- 闪存 (NOR, NAND, MCP, MMC, e.MMC, UFS, SD, MoviNAND, OneNAND, iNAND, Serial Flash, EEPROM, EPROM...), 微控制器, 逻辑器件 (CPLD, FPGA, PLD...)

封装支持

- PLCC, SOIC, SON, WSON, SSOP, CSP, BGA, uBGA, FPGA, QFP, TQFP, TSOP, PoP, DIP ...

器件测试

- Continuity, checksum, blank check, mis-insertion test, verify, backwards device, two pass verify

